

100 9ZL85L17KJ

Top Layer

120±0,1

80±0,1

90±0,1

100±0,1

95±0,1

GND

70±0,1

Ra10

Таблиця 1. Розташування шарів плати

Поз.	Найменування	Товщина, мм
1	Top Layer	0,035мм
2	FR4	>0,3мм
3	GND	0,035мм
4	FR4	0,8мм
5	VCC	0,035мм
6	FR4	>0,3мм
7	Bottom Layer	0,035мм

Таблиця 2. Параметри контактних майданчиків

Умовна позначка контакт. майданчика	Розміри контакт. майданчика, мм	Кількість КМ
	1,2x3,3	3
	1,4x1,2	4
	1,5x1,6	4
	1,4x0,4	16
	0,6x1,5	16
	1,1x1,6	22
	1,6x0,9	26
	1x0,6	26
	0,3x1,3	30
	1,6x0,3	48
	0,7x0,8	128
	1,4x0,3	144
	0,7x0,8	158

Таблиця 3. Параметри отворів

Умовна позначка отвору	Діаметр отвору, мм	Наявність металізації в отворі	Діаметр контактної площадки	Кількість отворів
	0,6±0,1	Є	1,1	10
	0,7±0,1	Є	1,2	250
	0,9±0,1	Є	1,7	16
	1,0±0,1	Є	1,8	24
	1,1±0,1	Є	1,6	10
	2,1±0,1	Є	4	2
	3±0,1	–	–	8
	3,5±0,1	Є	6	4

- * Розміри для довідок.
1. Крок координатної сітки 0,1 мм. Лінії координатної сітки нанесені через кожні 25 кроків.
2. Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79. III група жорсткості.
Клас точності 4 по ГОСТ 23751-86.
3. Конфігурацію провідників витримати за координатною сіткою. Ширина провідників 0,15 мм.
4. Плату виготовити комбінованим позитивним методом по ОСТ5-9707-88.
5. Покрити сплавом Розе чистий ТУ 6-09-4065.
6. Параметри контактних майданчиків наведені у таблиці 2.
7. Параметри отворів наведені у таблиці 3.

ДК4.1.758726.001

Плата друкована

Літ	Маса	Маштаб
0	23г	2:1

Архив 1

Склетекстоліт
FR4-4-35-1,5 ГОСТ 10316-78

КПІ ім. Ігоря Сікорського,
ФЕЛ, КЕОА, гр ДК-41